****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec(Korea)** | **congatec Asia**  |
| Ys Kim(김윤선 드림) | Crysta Lee |
| Phone: +82 (10) 2715-6418 | Phone: +886 2 25978577 |
| sales-asia@congatec.com<www.congatec.kr> | crysta.lee@congatec.com[www.congatec.kr](file:///C%3A%5CUsers%5Ccrystalee%5CDesktop%5CCrysta%5CPress%20release%5C2020%5Cpress%5CCOPR1924-elecktor-test-result-3.5%20inch%20SBC%5Cwww.congatec.kr)  |



*Text and photograph available at:* [*https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html*](https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html)

Press release

congatec(콩가텍), 3.5인치 SBC용 초강력 냉각 솔루션 제공

**질량이 차이를 만든다.**

**Seoul, Korea, 4 March 2020 \* \* \*** 고성능 임베디드 컴퓨팅 제품의 선두 제공업체인 congatec(콩가텍)이 3.5인치 SBC(Single Board Computer)에 대한 세 가지 새로운 프리미엄 임베디드 냉각 솔루션을 소개합니다. 표준형 COM Express 히트 스프레더의 PICMG 사양 기반과 초대형 사이즈 덕분에 매우 강력한 3.5인치 SBC 설계를 위한 최대 냉각 질량과 표면적을 제공합니다. 방열량이 표준화되어 있으며 모든 솔루션은 경금속으로 만들어진 거대한 히트 스프레더를 특징으로 하여 빠르고 효율적으로 CPU 핫스팟에서 배출된 열을 분산합니다. 히트 스프레더는 TDP에 따라 수동형 핀형 방열판 또는 능동형 팬 시스템으로 확장할 수 있습니다. 또한 표준화된 높이에서 세 가지 냉각 솔루션을 제공하는 congatec(콩가텍)을 통해 OEM은 향후 비슷한 TDP 요구 사항에 대해 크기가 동일한 냉각 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 여러 프로세스 세대에서 3.5인치 SBC 기반 임베디드 시스템을 훨씬 쉽게 확장할 수 있습니다. 모든 개발을 사내에서 진행한 새 냉각 솔루션의 첫 번째 구성은 8세대 Intel® Core™ 프로세서 시리즈(코드명: Whiskey Lake)를 기반으로 새로운 conga-JC370 3.5인치 SBC와 함께 사용하도록 최적화되었습니다.

"고객이 더욱 쉽게 임베디드 시스템을 설계할 수 있도록 냉각기능이 동작하면 일반적인 모든 업계 표준을 충족할 뿐만 아니라 초과할 정도의 아주 긴 MTBF가 지원되는 모든 표준형 폼 팩터를 위한 내구성이 매우 높은 사용자 지정 냉각 시스템을 개발하는 것도 저희의 오랜 전략이었습니다. 이 전략을 계속 사용하여 이제 3.5인치 SBC를 위한 새로운 고유 냉각 솔루션도 개발했습니다. 이는 프로세서와 I/O가 보드의 동일한 측면에 있는 기존 3.5인치 SBC와는 크게 다릅니다. 하우징의 연결 및 내부 시스템 공기흐름이 표준화되었으므로 보드의 하단에 솔루션을 마운트하여 대형 냉각 시스템을 위한 대규모 공간을 확보하고 동시에 개발자가 더 쉽게 시스템을 설계할 수 있도록 하였습니다.”라고 congatec(콩가텍)의 제품 관리팀 책임자 Martin Danzer는 풋프린트가 146x102mm인 전체 표면의 대부분을 활용하는 새로운 3.5인치 SBC를 위한 고급 냉각 개념을 설명했습니다.

세 가지 냉각 시스템은 3.5인치 SBC를 위해 설계되었으며 적시에 제한된 cTDP 업 모드에서 최대 45W의 냉각 용량이 필요한 향후 프로세서에 맞춰 개발되었습니다. 하우징에 발열을 분산하는 냉각 핀이 없는 히트 스프레더와 냉각 핀이 있는 수동형 방열판 및 통합된 팬이 있는 능동형 냉각 제품등으로 구성됩니다. 높은 부하를 실행하는 경우 수동형 냉각 제품에는 외부 시스템 팬을 권장합니다. 능동형 냉각은 독립 실행 작업을 위해 설계되었습니다. 시스템 통합을 쉽고 유연하게 하기 위해 위의 각 냉각 솔루션은 스레드 및 보어 홀로 구분해서 사용할 수 있습니다.

예를 들어 25W 8세대 Intel® Core™ i7 프로세서(i7-8665UE/코드명: Whiskey Lake)가 탑재된 3.5인치 시스템에서 사용되는 팬 기반 능동형 냉각 시스템은 가혹한 업계 환경에서의 24/7 시간 동작하는 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 완전한 냉각 시스템에서 팬은 더 안전하게 연결될 뿐만 아니라 마모를 줄이기 위해 특별히 고정되었습니다. 또한 기계와 윤활유를 최대한 보호하도록 특수 밀봉 및 추가 덮개가 베어링에 장착됩니다. 윤활유로 고성능 합성 오일을 사용하는 팬의 MTBF는 수십 년이고 산업 온도 범위는 -45~+85**°**C이며 산업 등급 충격 저항과 진동 저항 능력을 갖추고 있습니다.

새 3.5인치 SBC 에코시스템을 위한 congatec(콩가텍)의 냉각 솔루션에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. <https://www.congatec.com/en/technologies/35-sbc-based-on-8th-generation-intel-core-mobile-processors.html>

 <https://www.congatec.com/en/technologies/35-sbc-based-on-8th-generation-intel-core-mobile-processors.html>

**About congatec**

콩가텍은 임베디드 컴퓨팅 제품에 집중하는 굉장히 빠르게 성장하는 기술 집중형 업체입니다. 고성능 컴퓨터 모듈은 산업 자동화, 의료기술, 전송, 통신 및 다양한 어플리케이션과 제품에 사용되며 콩가텍은 글로벌 리더로서 벤처회사부터 글로벌 대기업까지 다양한 고객을 확보하고 있습니다. 2004년에 설립되어 독일 Deggendorf에 본사가 있고 2018년에는 매출 1.33 억불을 달성했습니다. 추가적인 정보는 [www.congatec.com](http://www.congatec.com) 나 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) 그리고 [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).를 참조해 주시기 바랍니다.

\* \* \*

*Intel and Intel Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*